

含浸めっき

◆サンプル

使用装置: 真空めっき処理装置

基板材質: AL板 粗化深さ $\sim 10\mu\text{m}$

基板サイズ: $100 \times 100\text{mm}$ $t=0.3\text{mm}$

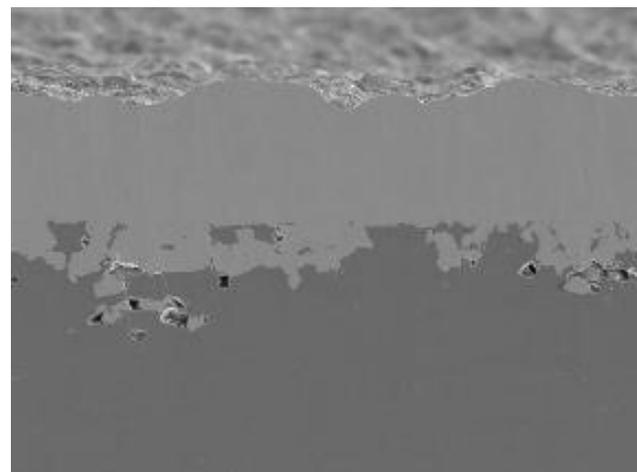
成膜エリア: Cuめっき部 ($\square 85\text{mm}$)

浴種: 硫酸銅 (添加剤レス)

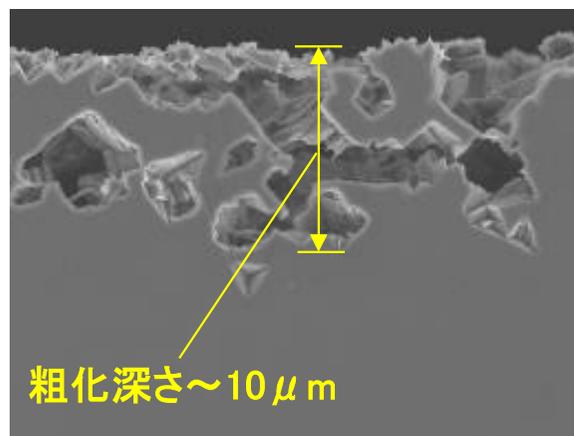
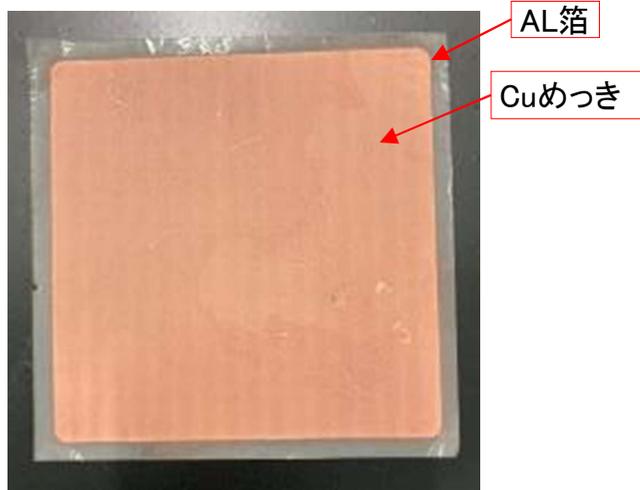
狙い膜厚: $20\mu\text{m}$

電流密度: $5\text{A}/\text{dm}^2$

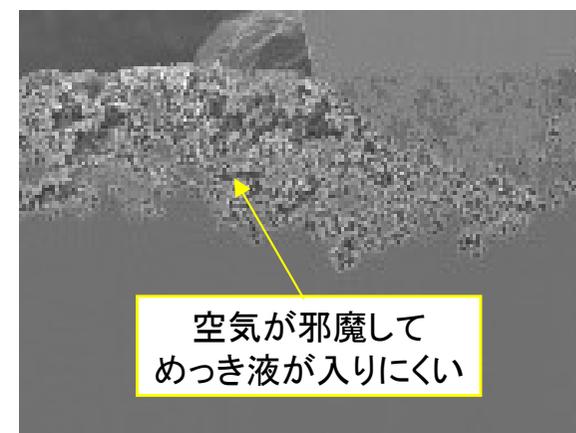
減圧(電解質膜の下)と加圧(電解質膜の上)の差圧により、含浸効果を発現させ、粗化処理されたアルミ箔へ前処理レスでCuめっきをしました。アンカー効果で剥離しません。



めっき後



めっき前



従来めっき

